

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2021年3月3日投资者关系活动记录表

编号：2021-03-001

| | |
|-----------------------|--|
| 投资者关系 活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 及人员姓名 | T.RowePrice 普信：郑闻立、方舒 Grand Alliance Asset Management（浩成资产管理有限公司）：苏怡文 |
| 时间 | 9:30-10:45 |
| 地点 | 公司办公室 |
| 上市公司接待 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：蒋威 证券事务代表：王渝 |
| 投资者关系活 动主要内容介 绍 | <p>一、公司发展历程介绍</p> <p>回复：公司成立至今已 28 年，战略方向明确，始终坚守主业，专注于线路板行业发展，从传统的 PCB 样板、小批量板拓展至以 IC 封装基板、半导体测试板业务为代表的半导体业务，通过自身的研发投入和积累实现产品和技术的升级。</p> <p>二、IC 封装基板业务情况介绍</p> <p>回复：公司于 2012 年投资建设 IC 封装基板产线，起点较高，按照国际一流客户的标准设计和建设厂房、产线，产能设计为达产后 10000 平方米/月。2018 年通过三星认证，并启动二期扩产，新增投资 10000 平方米/月产能，整体产能扩充至 20000 平方米/月。目前整体产能利用率</p> |

处于较高水平，良率已提升至 95%，市场需求比较旺盛。

IC 封装基板行业进入门槛高，存在技术、资金和客户等方面的壁垒，制程工艺难，认证时间长，公司目前产能有限，规模效应还没有显现出来。客户群主要是芯片设计公司和封测厂，国内客户居多，也有部分韩国和台湾客户。IC 封装基板未来是公司重点发展的战略方向，也是重点投资的领域。

三、如何看应用端领域市场的需求？

回复：PCB 领域，从下游分类看，计算机、通讯、消费类电子占 PCB 行业需求约 2/3，工控、医疗、军工、汽车行业等占 1/3。2020 年，PCB 行业整体表现一般，呈现前高后低的走势，尤其受通信行业影响较大，Q3 是行业需求表现最弱的一个季度。医疗行业需求受益于疫情，表现较好，下半年有所回落；计算机行业受益于在线办公，也实现较好的增长；汽车、军工稳中有升；消费电子表现平稳。2021 年，行业整体需求有望回升，一方面因为疫情缓解，全球经济复苏，另一方面产业链向国内转移的趋势仍将持续，国内的复工复产领先全球，技术进一步提升，成本优势仍存在。未来行业表现仍将分化，国内行业增速会好于海外市场，技术升级的趋势仍将持续，高端产品需求会持续火爆，中低端市场会面临较大的压力。

半导体行业处于高景气周期，国内呈现供需两旺的格局，从产成品、到原材料都面临供给不足、产品涨价的趋势。按照行业以及咨询机构的观点，ABF 载板、BT 载板、HDI 板都将处于供不应求的状态，其供给扩张的速度远远落后于需求增长的速度，越高端的产品，供给不足的情况越严重，产能扩张所需的投资规模越大、产能释放周期越长。

从供给端而言，IC 载板行业本来就是少数者的游戏，在 2019 年之前因为笔电、手机行业景气度较低，国内需求没有真正起来，行业主要参与者经营状况都不佳，没有实施扩产，导致行业供给受限。目前的现状是以台湾欣兴电子、景硕为代表的一线厂商都在加大力度扩张 ABF 载板（面向 CPU\GPU 芯片）的产能，新建或者改造部分 BT 载板产线，力求更进一步绑定海外大客户；国内以深南、越亚和兴森代表的厂商则在加

| | |
|----------------------|--|
| | <p>大力度扩张 BT 载板的产能，而海外 BT 载板的产能并没有增长，出现一定的溢出效应。从 2020 年 12 月份开始，无论是 ABF 载板还是 BT 载板，都出现不同程度的涨价。</p> <p>四、与大基金合作的半导体封装产业项目情况介绍</p> <p>回复：项目总投资 30 亿人民币，其中一期投资 16 亿人民币，月产能 30000 平方米 IC 封装基板和 15000 平方米类载板，其中公司持股 41%，广州科学城集团持股 25%，大基金持股 24%，合伙企业（管理团队）持股 10%，预计 2021 年年中完成厂房建设，下半年完成厂房装修和设备安装调试。</p> <p>五、半导体测试板业务情况介绍</p> <p>回复：行业前景不错，属于高端定制化的高附加值业务，国内涉足的厂商较少。公司通过收购美国 Harbor 公司，进入该领域，在全球半导体测试板整体解决方案领域具有优势地位，主要客户均为一流半导体公司。向客户提供的是完全定制化的服务，附加值较高，对应的产品价格和毛利率水平都较高。产品应用于从晶圆测试到封装前后测试的各流程中，类型包括接口板、探针卡和老化板，公司目前的半导体测试板产品主要为接口板和探针卡。</p> |
| <p>附件清单 (如有)</p> | |
| <p>日期</p> | <p>2021 年 3 月 3 日</p> |